

JEITA LPB-SC JEVeC DAY2023TG

活動報告

半導体&システム開発技術サブコミッティ
SSD-SC



JEVeC DAY2023TG 概要

● 目的

- JEVeC DAY2023の準備・当日対応
- 技術展示によるSSD-SCの宣伝、参加企業の募集

● 期間

- 2023/09/2～2023/11/27

● 成果物

- JEVeC DAY2023イベントへの参加
- 技術展示によるSSD-SCの宣伝

活動スケジュール

| | 2023年9月 | 10月 | 11月 | 12月 | | |
|---------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|---|--|--|
| SSD-SC | ▲参加承認(9/15) | | | ▲関西(11/26) | | |
| 合同会議 | | | | | | |
| JEVeC-DAY 2023-01本番 | 申込 ▲(9/15) | ▲展示概要締切 ▲HP公開 | 当日(11/27) ▲ | | | |
| JEVeC DAY2023-01TG | | ▲(10/6)概要検討 | ▲(11/2)内容検討 | ▲(12/8)振返り | | |
| <展示> | | 当日要員検討 チラシ内容確認(1/27) ▲ 展示概要検討 | | ▲(11/26)当日 ・設営 ・展示説明 ・撤収 ・講演者 | | |
| | | 各活動 展示内容検討 | | | | |

活動報告

● 展示

タイトル：LPBフォーマットのご紹介と会員募集

- 展示はタペストリー3件を展示し、配るチラシを用意
- 状況
 - 何名かは興味を持って頂き話が出来た
- 反省点
 - タペストリー変更対応が出来なかった

JEVeC DAY 開催概要

名称 : JEVeC DAY 2023
日時 : 2023年11月27日(月) 10:00-18:00
主催 : 日本EDAベンチャー連絡会(JEVeC)
参加費 : 無料
会場 : 川崎市産業振興会館(リアル開催のみ)
URL : <https://www.jevec.jp/jevecday2023/>

結果概要:

- ・事前申込者数 : 234名
- ・当日参加者数 : 155名
- ・参加率 : 66.2%

出展社費用

技術展示 : 2万円/1件

JEVec DAY 開催概要(追加)

○イベント概要

- ・日時：2023年11月27日（月）10:00～19:55（受付開始：10:00）
- ・会場：川崎市産業振興会館
- ・構成
 - ・講演会（特別招待講演：1件，チュートリアル1件，キーノート：3件，技術講演：7件）
 - ・展示会（21社出展）
 - ・懇親会

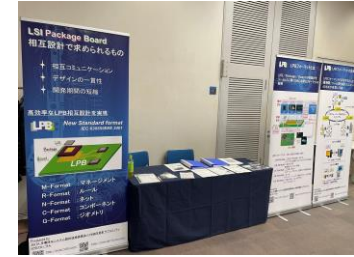
○参加者数

- ・事前申込者数：234名（外部：180名，関係者：54名）
- ・当日参加者数：155名（外部：101名，関係者：54名）
- ・当日参加率：66.2%
- ・その他
 - 昼休憩時に展示会場で軽食（おにぎりセット）を配布
 - 午後14:20～14:30の10minの休憩
 - 16:00～17:00までの休憩(展示会場ではミニセミナーを実施；申し込み要)

技術展示

1. 展示内容

1. SCの活動内容紹介と委員募集
2. LPBフォーマットの紹介
3. 活動紹介の資料
4. JEITA紹介資料



2023年度 JEITA 半導体システムソリューション技術委員会
半導体システム開発技術サブコミュニティ委員募集

1. 事業目的
半導体システム開発技術サブコミュニティ (SSD-SC) では下記の理念に基づき電子機器製品の開発効率を上げると共に、各属の優れた設計技術が基盤化要素として最大限に発揮される市場環境を形成することを目指します。

- ・ 新しい製品を効率的に開発すること
- ・ LPB 協賛設計者を募集
- ・ 開発エコシステムを構築する

2. サブコミュニティの構成
半導体システム開発技術 SC の構成と各分科会の活動内容を説明します。上記の 3 つの設下で事業内容ごとにタスクグループ (TG) を設けて成果物を作成しています。

3. 事業内容
3.1 標準化設計標準化 WG (STD-WG)
標準化電気部品標準化団体への参加と発行までの推進
標準化団体 (IEC, IEEE-SA, 他) と連携
IEEE 標準団体への加盟及び IEEE P2410G に参加
設計標準を協議・議論、P400WG への積極参加
設計標準やシステム活動設計標準の策定・推進、半導体設計標準化シンポジウム (ICSS, Japan 企画運営)

3.2 LPB 相互設計・検証 WG (LPB-WG)
設計インフラ (設計環境・ライブラリ) 整備
解決事例、ガイドライン、デザインキット開発
IEC 63055/IEEE 2401 LPB フォーマット改良提案
LPB 相互設計の普及 (イベント、セミナー、IP、展示、ワークショップ、フォーラムの運営)

3.3 システム開発プロトタイプ化 WG (SP-WG)
開発におけるプロトタイプ化の活用
MPC8548 単体 (実装したコンポーネント) を標準モジュールによる検証設計と半導体設計の境界領域での相互検証 (IEC 62433 シリウスや IHS 等の利用技術) EMC を考慮した設計方法を伝送路・電源回路において IC のデザインに普及して活用

4. 委員募集
半導体、受動部品、コネクタ、ハードウェア、機器開発 (セット)、設計・開発受託 (基板設計・OSAT・EMS)、エンジニアリングサービス・コンサルタント、EDA ソフトウェア

LPB標準フォーマット IEC 63055/IEEE 2401-2019
LSI-Package-Board Interoperable Design Process

1. LPB標準フォーマットによるコンポーネント、デザインキット
LSIパッケージボード相互設計を推進する上では標準化団体と協賛企業が行なう標準の策定が最も重要なステップです。LPB標準フォーマットを策定しました (図1)。

1. プロジェクト管理 (各 Format)
2. ネットワーク (各 Format)
3. コンポーネント (各 Format)
4. デザインルール (各 Format)
5. ジェネラトリ (各 Format)
6. 検証 (各 Format)

2. サプライヤンにおける情報の収集
設計者から収集した情報を元に、標準化団体へ提供し、標準化団体の承認を得ます。また標準化団体の承認を得てデザインキットを公開しています。

3. 設計情報の短縮
設計情報の短縮は、設計者の負担を軽減し、開発期間を短縮します。また、標準化団体の承認を得てデザインキットを公開しています。

4. LPB相互設計による開発期間短縮
LPB相互設計により、開発期間を短縮します。また、標準化団体の承認を得てデザインキットを公開しています。

半導体&システム開発技術SC 活動紹介
第1回LPBフォーラム (2023年3月9日開催)

第1回LPBフォーラム (2023年3月9日開催)
LPBワークショップ2023 (2023年9月1日開催)

第1回LPBフォーラム (2023年3月9日開催)
LPBワークショップ2023 (2023年9月1日開催)

第1回LPBフォーラム (2023年3月9日開催)
LPBワークショップ2023 (2023年9月1日開催)

第1回LPBフォーラム (2023年3月9日開催)
LPBワークショップ2023 (2023年9月1日開催)

